

ともに歩む、その先の革新へ



2026年度 第2四半期 決算説明会

イビデン株式会社(4062)
2026年10月30日

このプレゼンテーション資料には、2026年10月29日現在の将来に関する前提・見通し・計画に基づく予測が含まれております。

世界経済・競合状況・為替変動等にかかわるリスクや不確定要因により実際の業績が記載の予測と大幅に異なる可能性があります。

2026年度上半期 実績

2026年度(上半期) 売上高・営業利益・純利益 実績

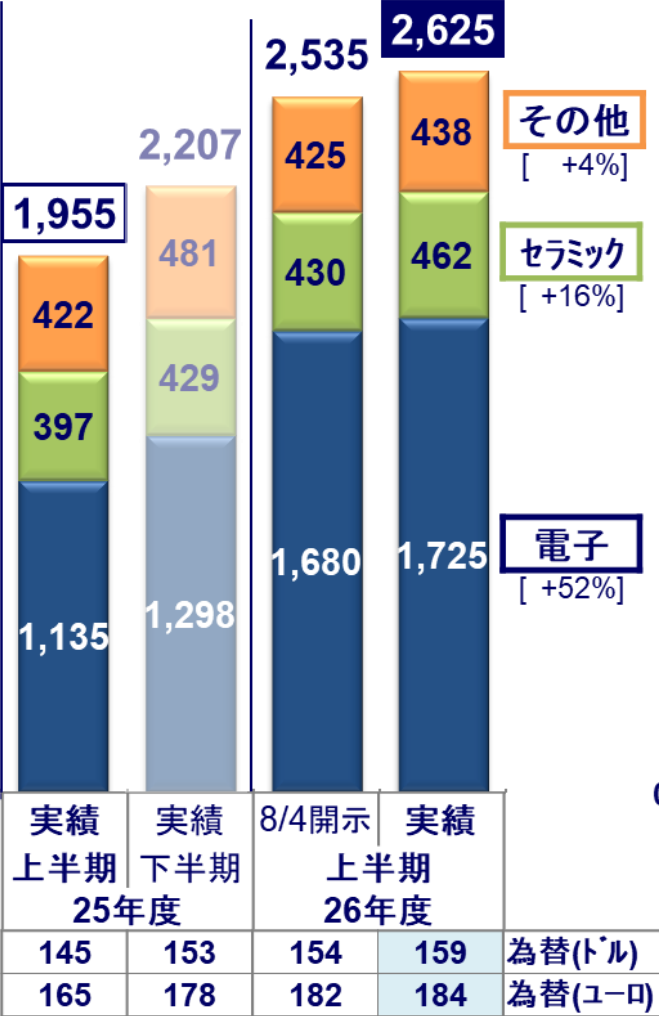
IBIDEN

売上高

[]は
前年同期比

(億円)

前年同期比
+34%



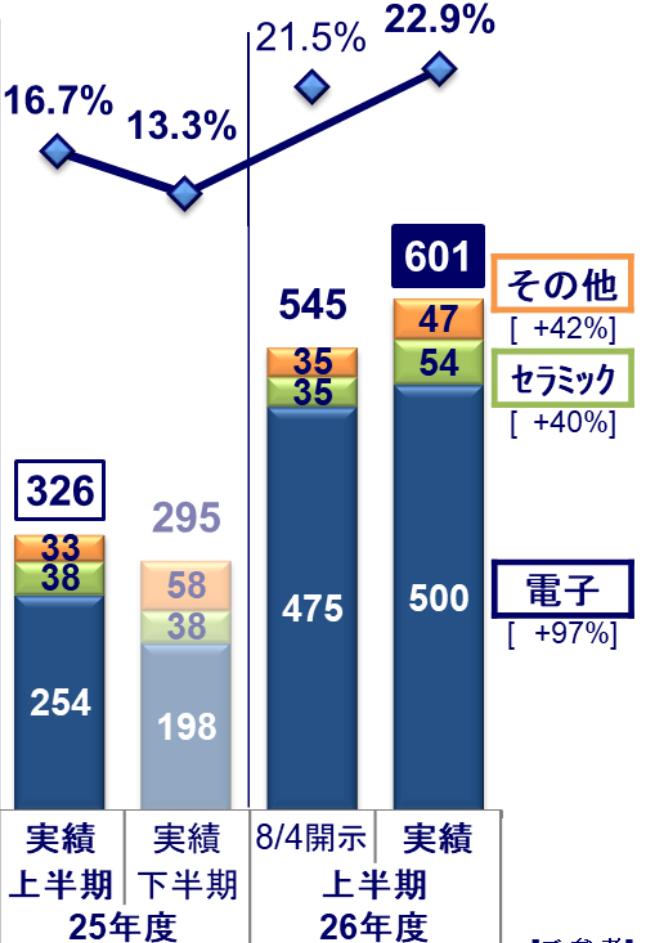
営業利益

[]は
前年同期比

(億円)

前年同期比
+85%

営業利益率

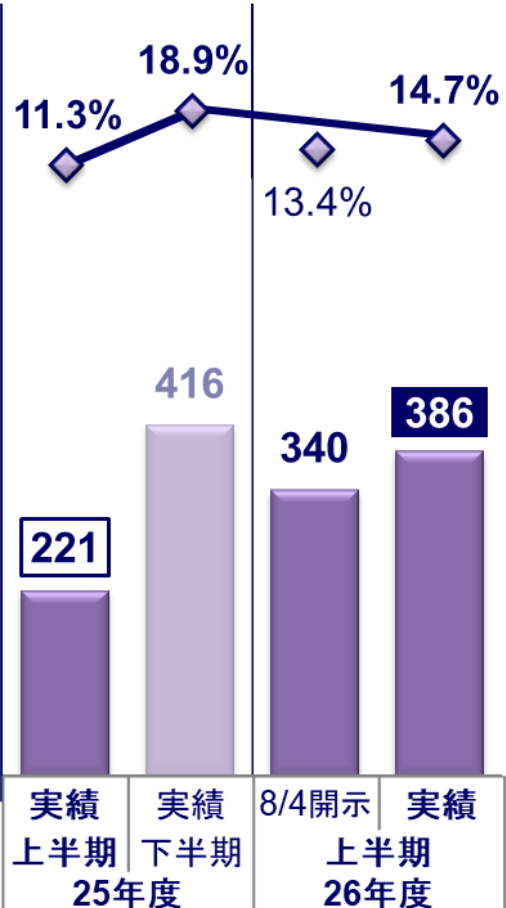


純利益

(億円)

前年同期比
+75%

純利益率



[ご参考]

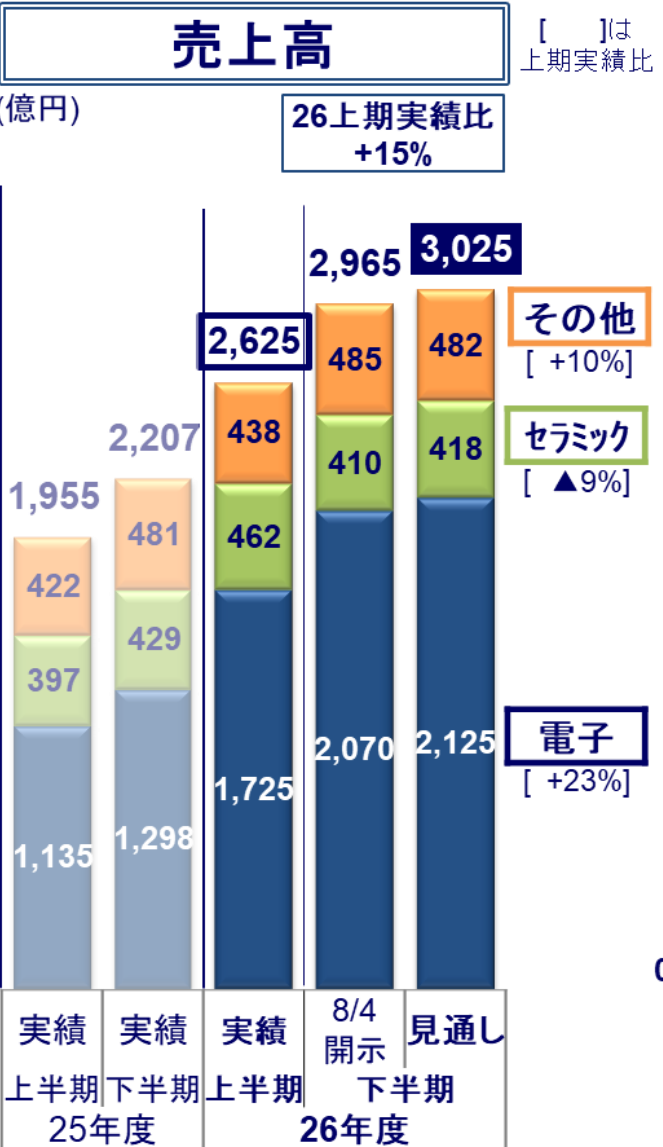
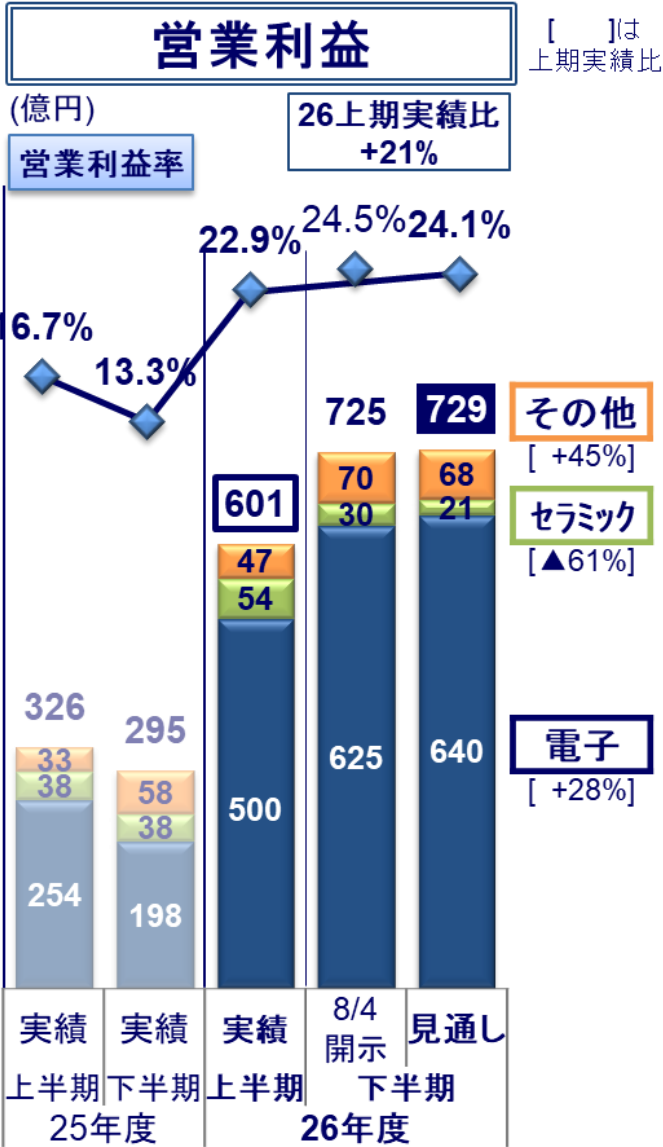
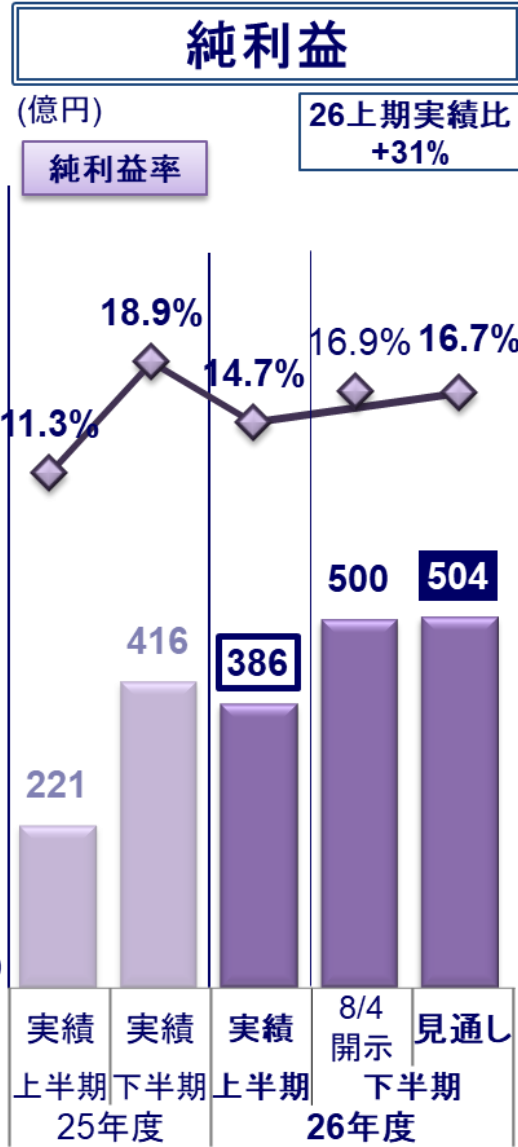
政策投資株売却益
(税引後換算)

-	345	-	-
---	-----	---	---

Page#4/17

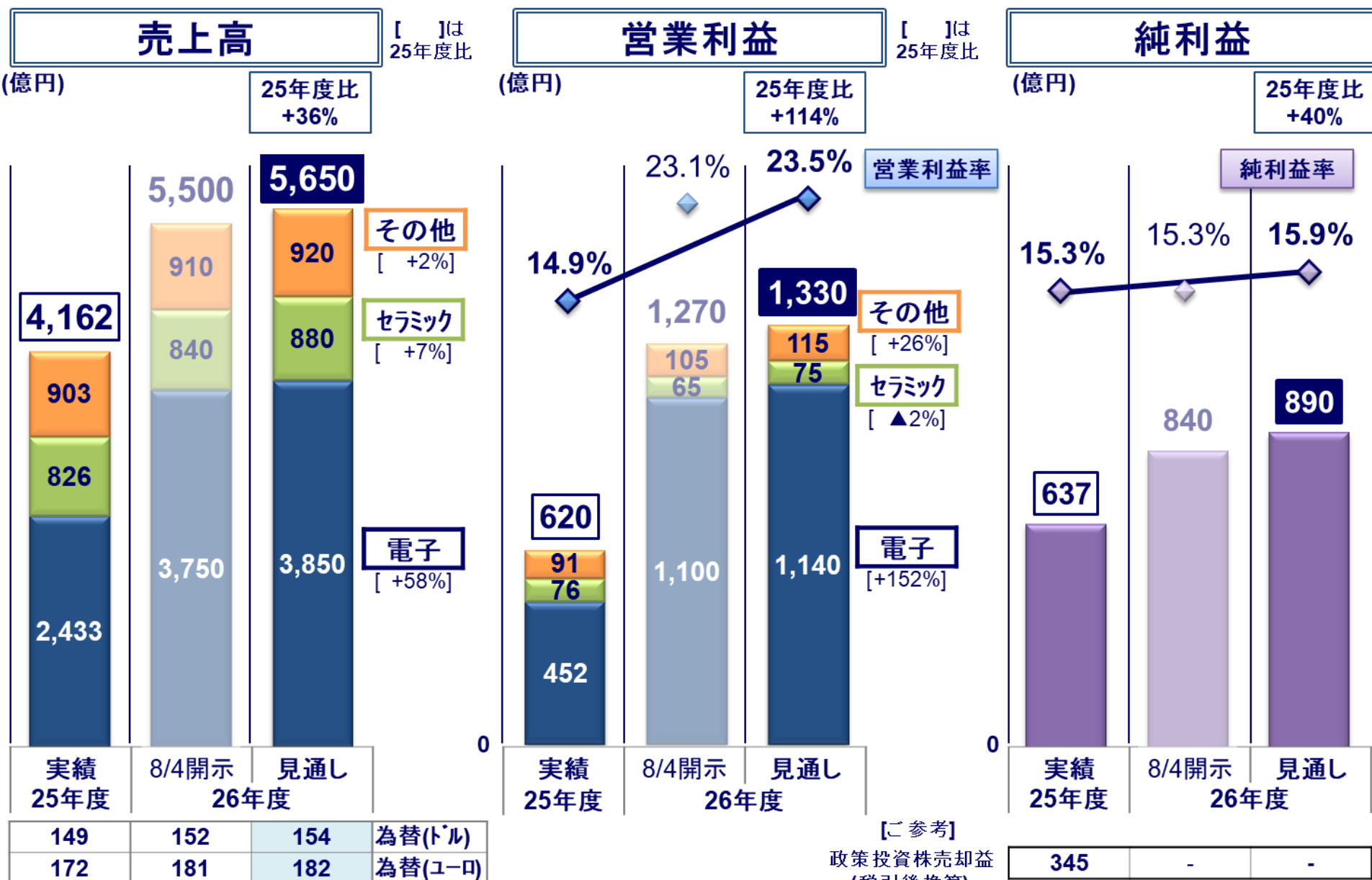
2026年度下半期 見通し

2026年度(下半期) 売上高・営業利益・純利益 見通し



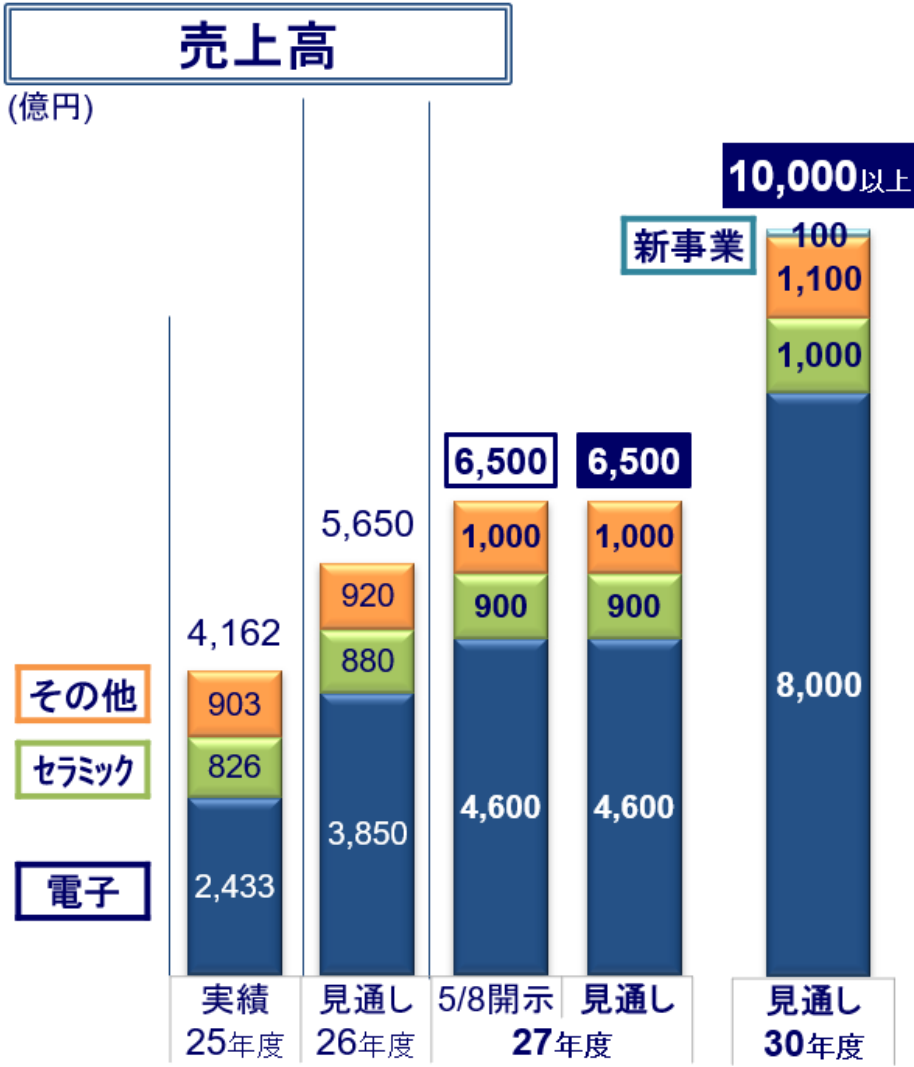
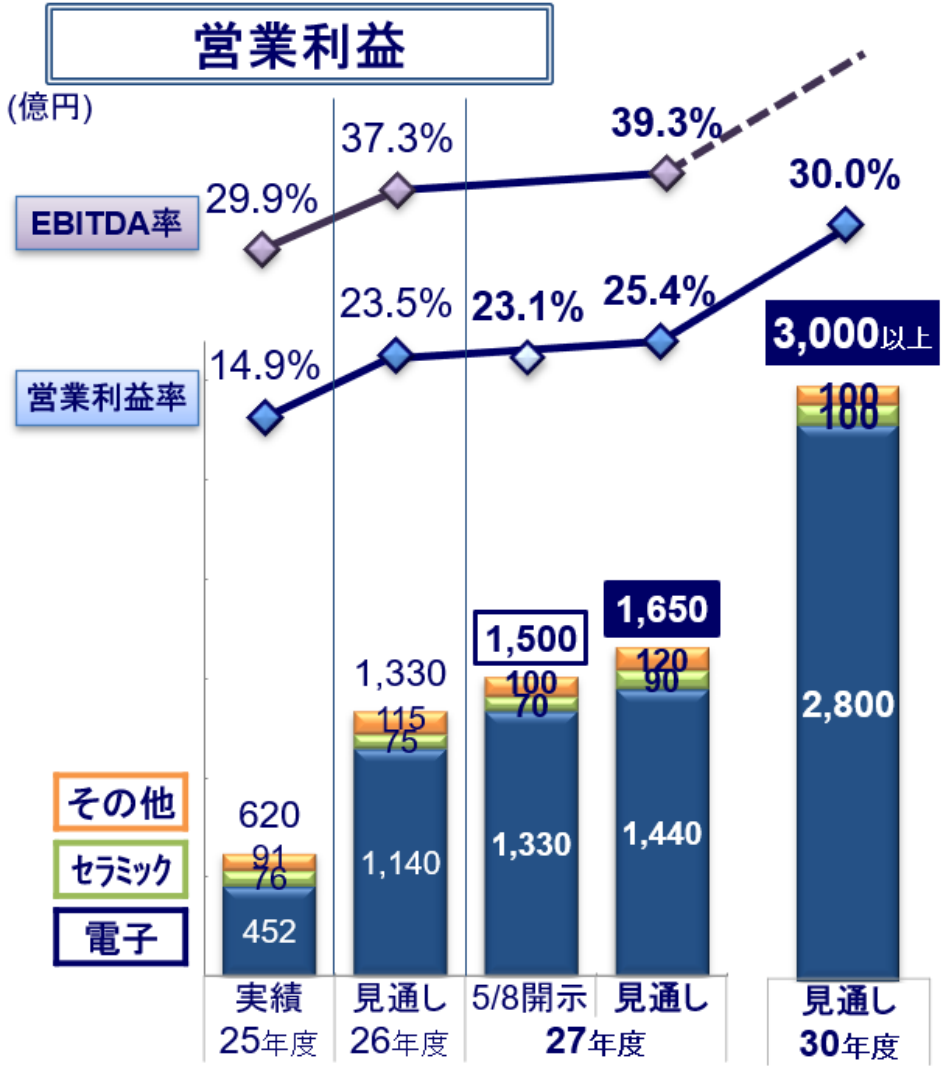
145	153	159	150	150	為替(ドル)
165	178	184	180	180	為替(ユーロ)

2026年度(通期) 売上高・営業利益・純利益 見通し



中期業績見通し

- 2027年度の営業利益ガイダンスを上方修正(+150億円)し、全セグメントで増収増益を狙う
- 電子事業を軸に、2030年度に「売上1兆円・営業利益3,000億円(営利率30%)」を目指す

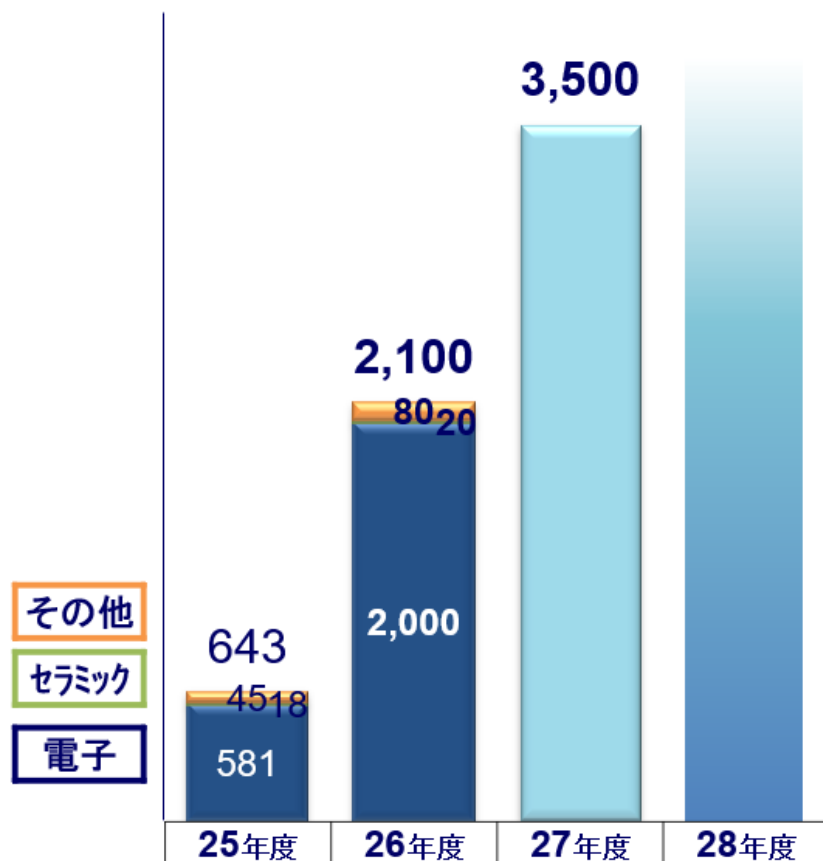


設備投資検収額・減価償却費 見通し

- 最先端ICパッケージ基板の需要増加に応えるべく、高水準の投資が当面継続する見通し
- 確実な量産立上げを実現すべく、人材採用強化・経験者の戦略的配置・省人化を推進する

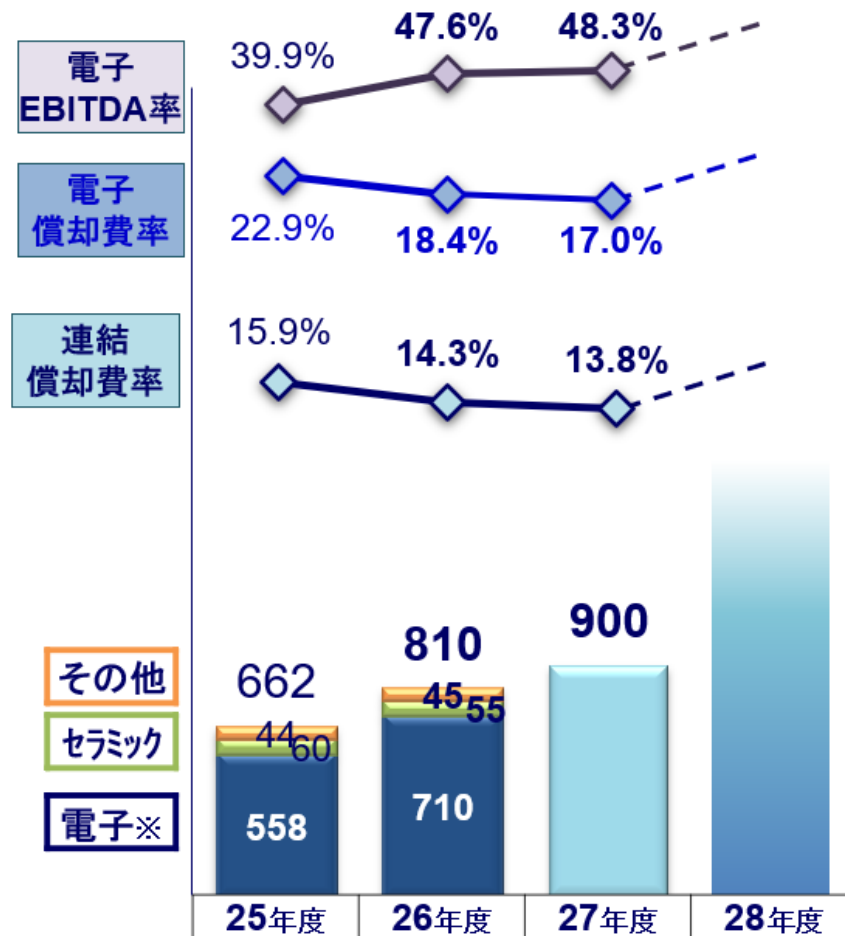
設備投資額

(億円)



減価償却費

(億円)



※休止固定資産の減価償却費を含む

市場見通しと 当社事業展望

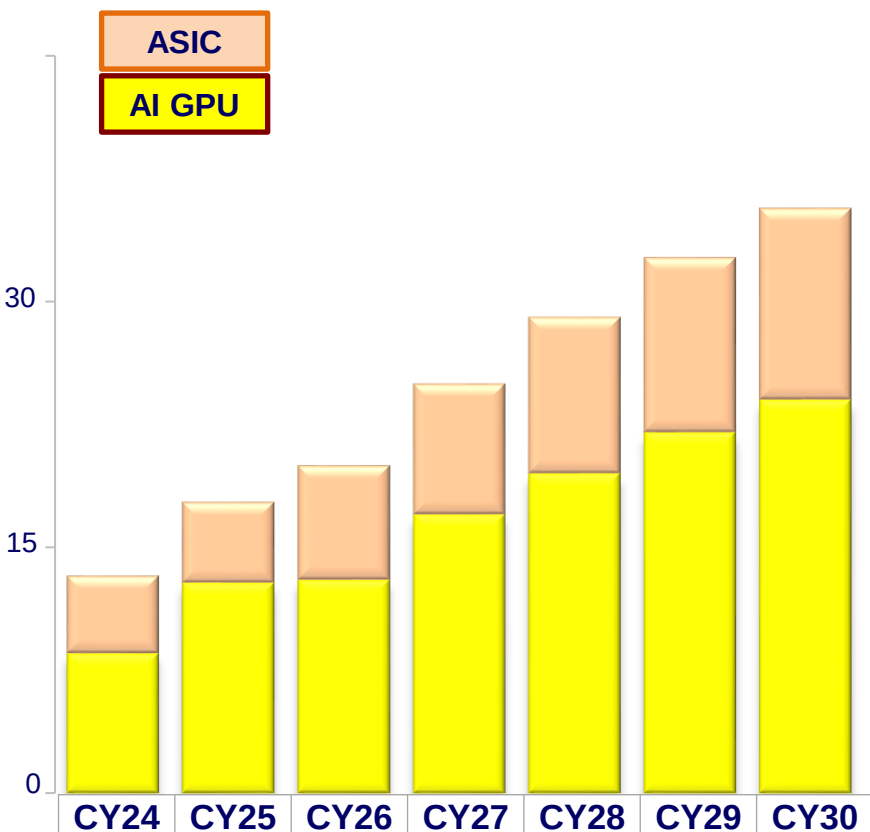
電子市場の動向と変化

- AI GPUおよびAI推論に特化したASIC市場は、引き続き堅調に需要拡大する見通し
- AI用途の拡大(推論・エージェント)に伴い、サーバー向けハイエンドCPUの需要見通しを引き上げ
- サーバー間およびデータセンター間の高速伝送を実現するため、スイッチICの高性能化が見込まれる

AI GPU/ASIC市場

(百万個)

(外部調査会社の情報を基に推定)



CPUその他市場

(百万個)

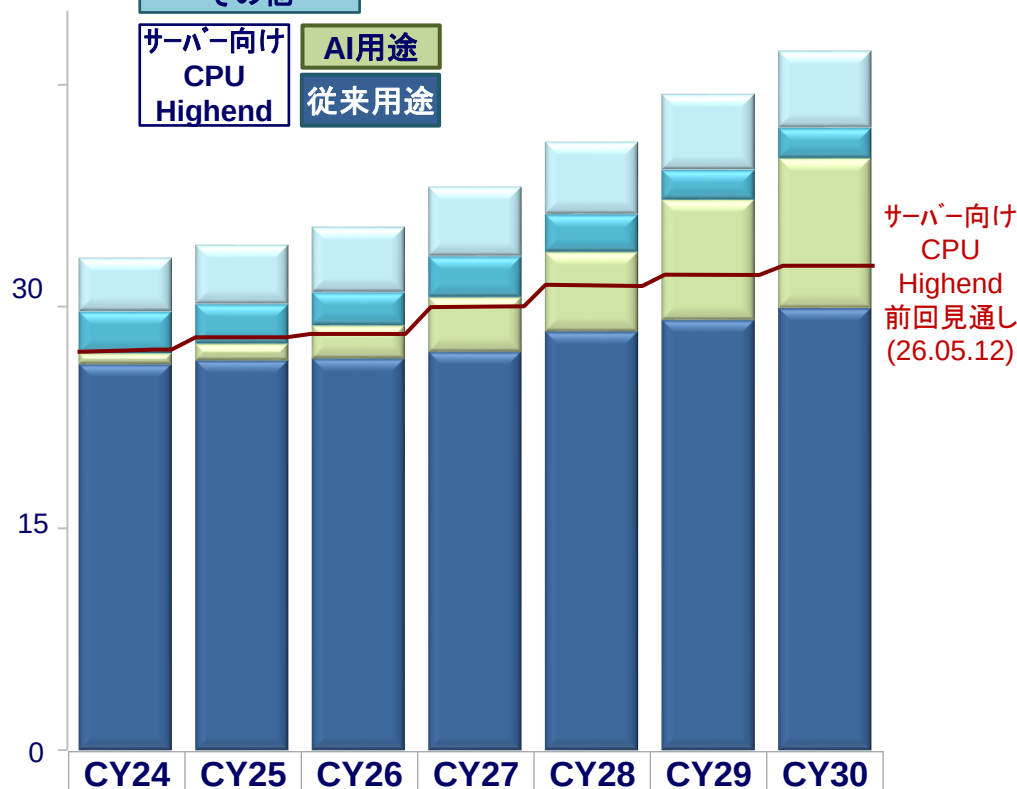
データセンター向け
スイッチIC

サーバー向けCPU
その他

サーバー向け
CPU
Highend

AI用途

従来用途



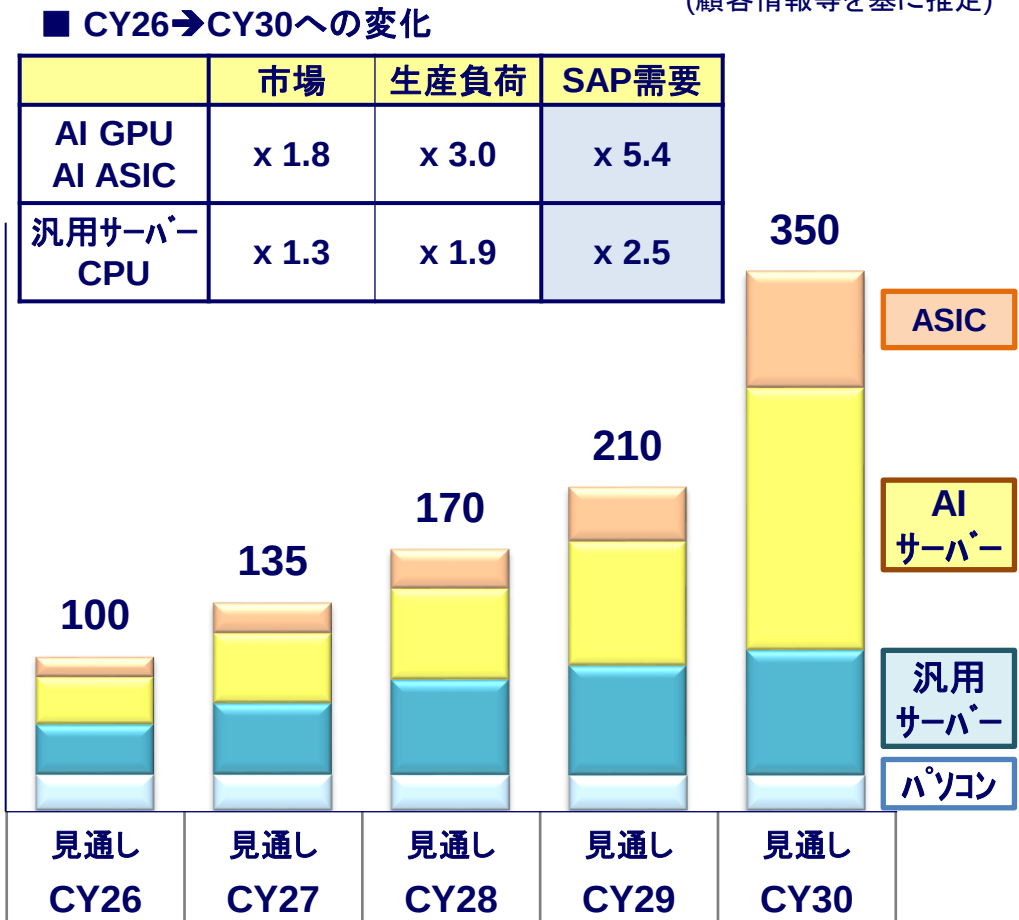
ICパッケージ基板の需要見通しと当社能増計画



- ICパッケージ基板の大型化・高多層化に伴い、SAP総需要は業界供給能力を大きく上回る見通し
- 最先端半導体向けを中心とした能増により、引き続きハイエンド市場でのトップシェアを維持する

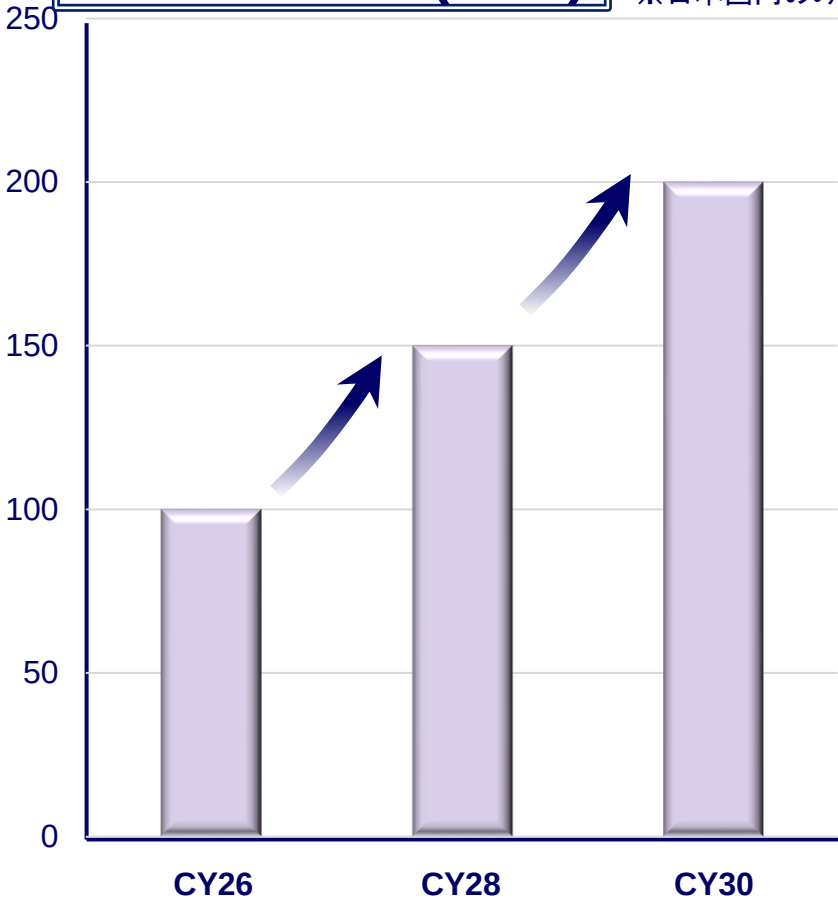
SAP*総需要(面積)

※SAP : Semi Additive Process
※26年を「100」として指数化
(顧客情報等を基に推定)



当社能増計画(指数)

※日本国内のみ



電子事業の成長に向けた設備投資

- 河間事業場Cell6の建屋容積を最大活用する追加投資を実行し、SAP能力を増強する
- Cell7・9を含む追加投資については、顧客と詳細条件を固め、26年度中に決定・開示を目指す

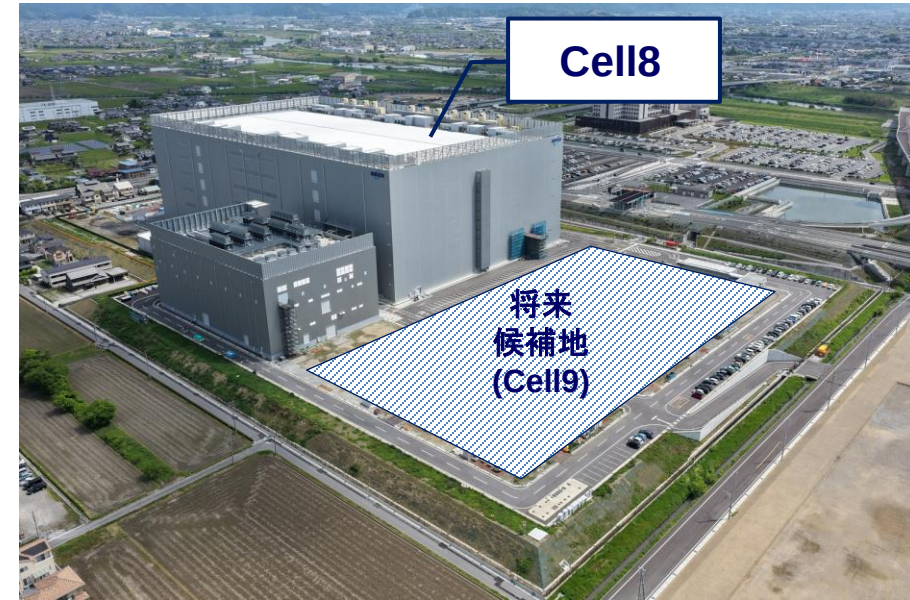
河間事業場

項目	内容
投資額 (Cell6)	既発表: 2,200億円 今回追加分: 1,500億円
稼働時期	2029年度より順次稼働
生産品目	AI ASIC向け 高機能ICパッケージ基板



大野事業場

項目	内容
投資額 (Cell8)	既発表: 2,800億円 ※建屋容積の最大活用を検討中
稼働時期	2027年度より順次稼働
生産品目	AI GPU向け 高機能ICパッケージ基板



ICパッケージ基板の進化と開発

- 大型化・高多層化に加え、コア構造の複雑化・部品内蔵が進展し、付加価値増加が見込まれる
- 引き続き全方位で必要となる要素技術を先行開発し、顧客の最先端半導体開発を支える

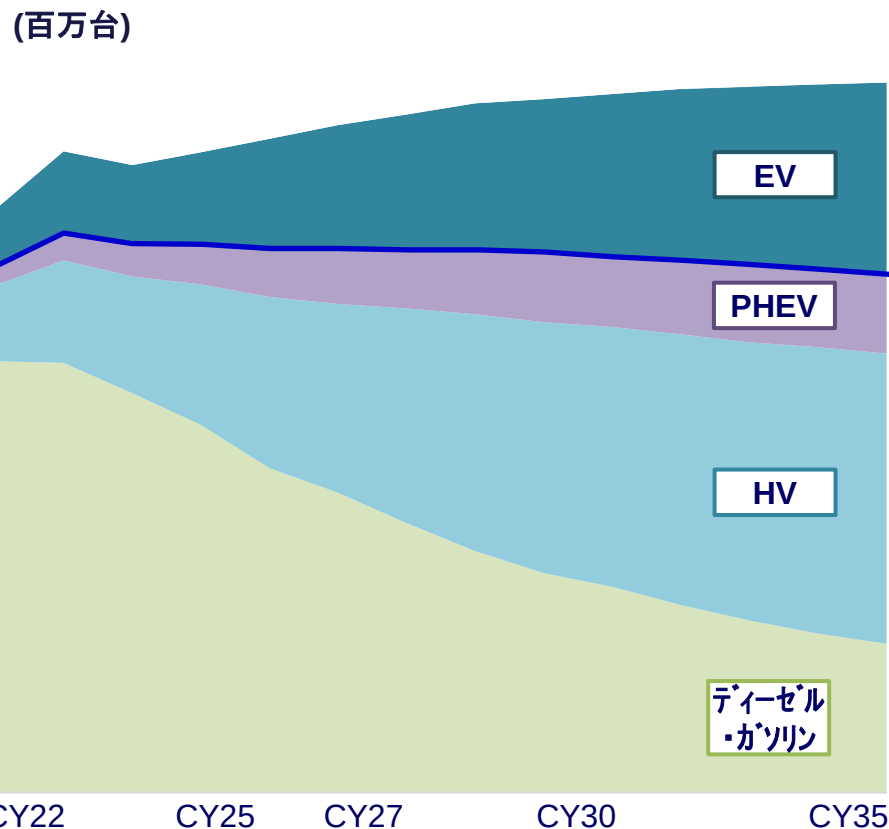
	CY25	CY26	CY28	CY30～
Dieサイズ(レチクル)	3.5	5.0	7.5	9 <
基板サイズ	80 x 80	90 x 90	110 x 110	130 x 130 <
SAP	9-X-9	10-X-10	12-X-12	14-X-14
構造(2.5D)				
(インターポーザー型)	<p>電源強化</p> <p>電源強化</p>			
(シリコンブリッジ型)	<p>電源強化</p> <p>電源強化</p>			
光電変換	<p>高速化 + 低消費電力</p> <p>(ボード間接続)</p> <p>(パッケージ間接続)</p> <p>(ダイ間接続)</p>			

セラミック市場の動向と変化

- 内燃機関向け製品の見通しに変化なし、引き続き新興国の商用車・建機/農機需要を取り込む
- EV向け製品は、既存顧客でのトップシェア維持と新規顧客獲得によって事業拡大を狙う
- グラファイト製品は、複数顧客からの引合いを確実に取込み、原子力分野(北米)で事業拡大を狙う

パワートレイン市場

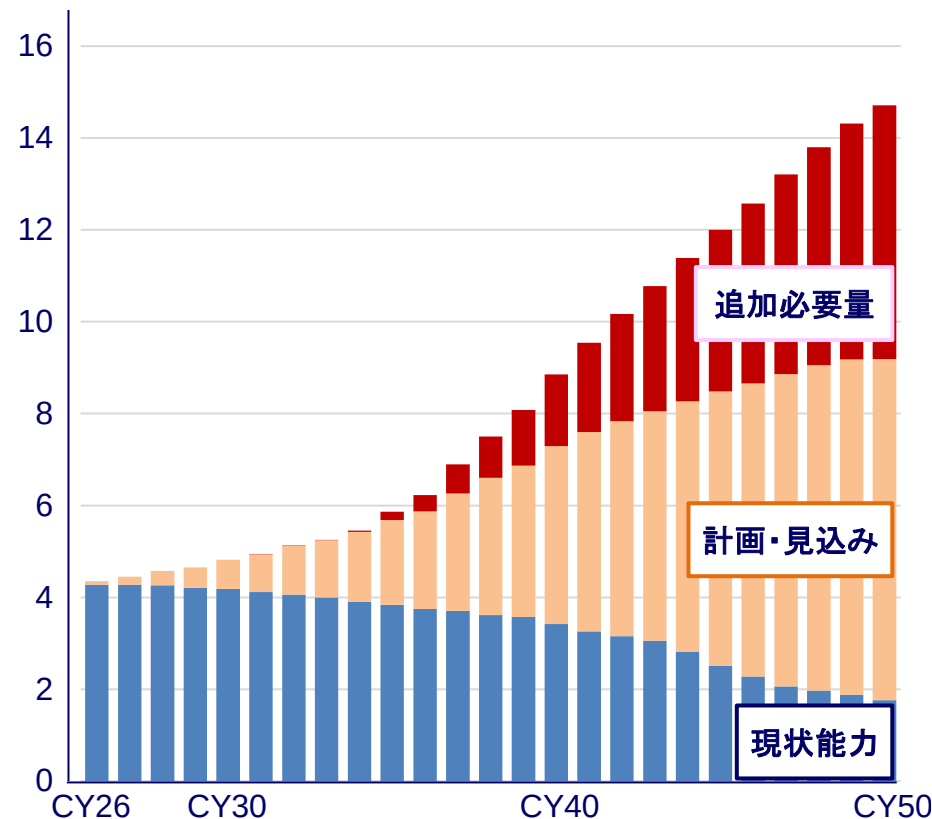
(外部調査会社の情報を基に推定)



原子力発電

(外部調査会社の情報を基に推定)

(100GWe)



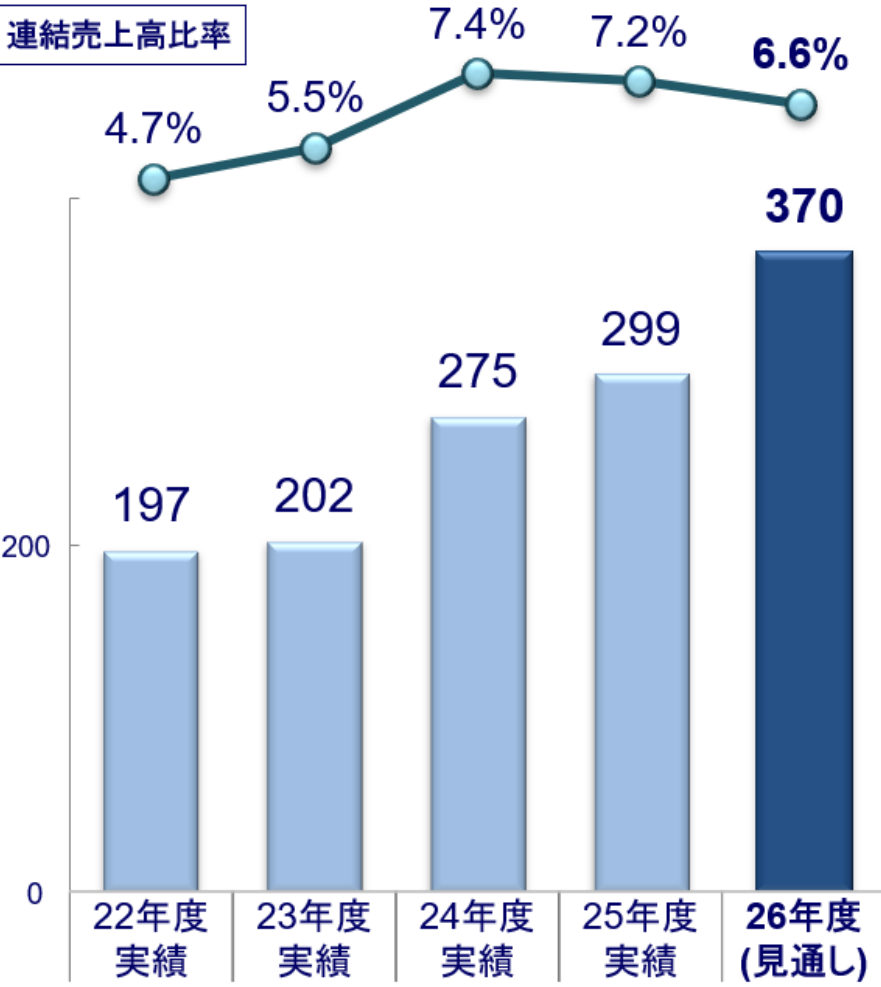
次の成長に向けた研究開発活動

□ 社内開発とオープンイノベーションによる外部の知見の活用で事業領域拡大と新規事業創出を目指す

研究開発費の推移

(億円)

連結売上高比率

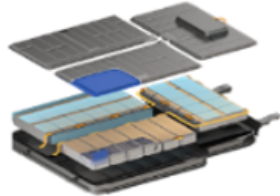


当社の研究開発領域

NEV 領域

LiB安全部材, 耐熱断熱材, 耐熱絶縁部材

蓄電池安全部材に関する
新規製品の採用が決定し、
27年1Qに量産開始



EV車載蓄電池

特殊 基板 領域

パワーモジュールおよびロボティクス向け製品

超小型アクチュエーターを開発し、
お客様での評価を開始



新領域

植物活性化剤, CO2固定化技術

- ・LEAFENERGYの海外農業展開を推進
- ・研究施設開設に向けた岐阜市との立地協定を締結
※2028年10月開設予定

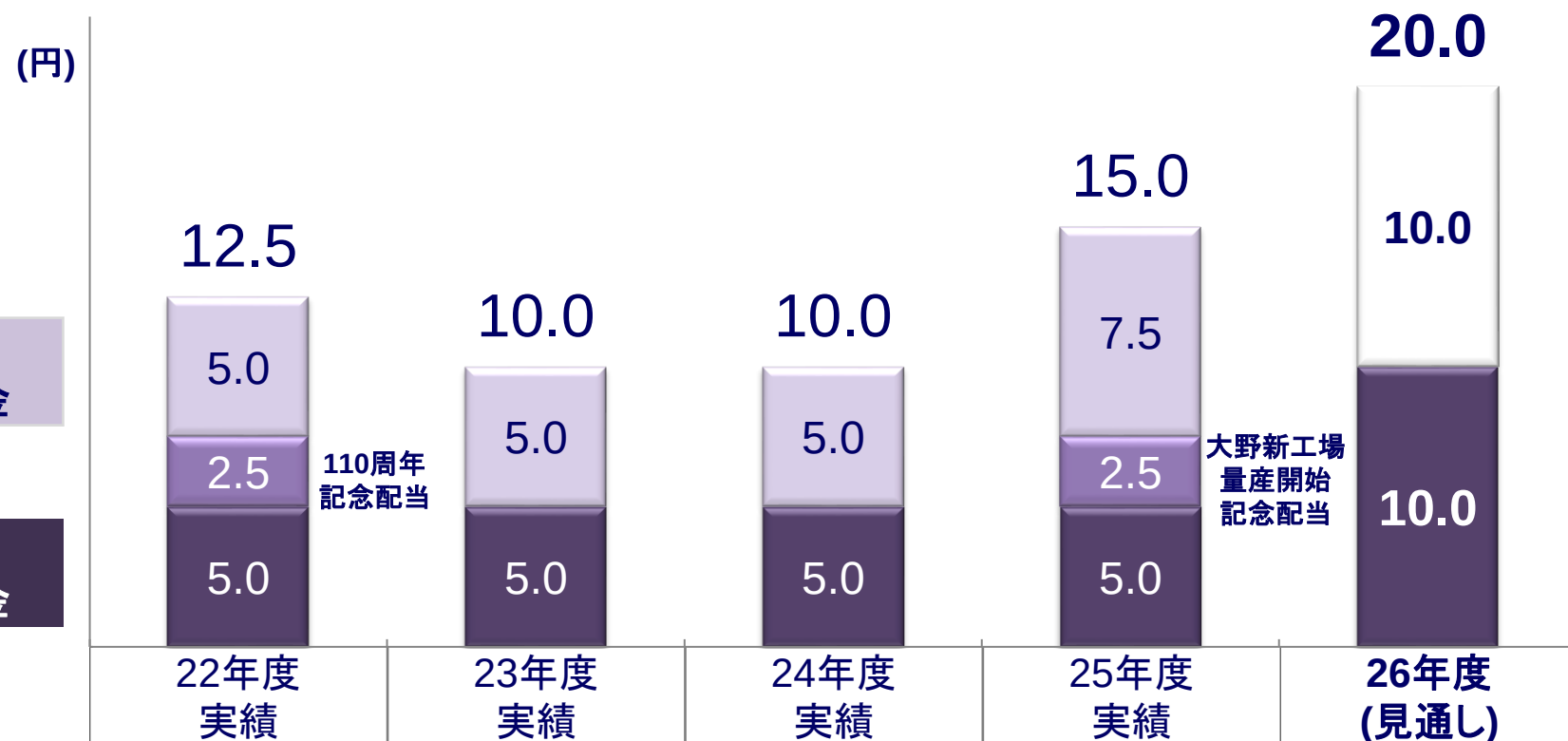


株主還元

- 投資家層の拡大と流動性向上を目的に、26年10月1日付で1:2の株式分割を実施
- 26年度中間配当は、25年度期末配当対比で2.5円の増配となる10.0円/株にて決議
- 株主還元方針は、成長投資・研究開発・人的資本への資金配分と有利子負債の縮減による強固な財務体質の維持を前提に、配当性向20%を目安とし、累進配当(30年度まで)を継続

一株当たり配当金

※2026年10月1日付の株式分割を考慮し、
過年度の1株当たり配当金を遡及換算して表示



ともに歩む、その先の革新へ

